

SMT-II Reinigungssystem für unbestückte Leiterplatten 100% ESD!



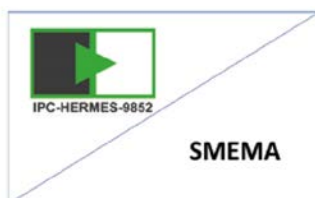
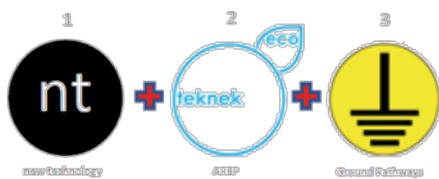
Perfekte Reinigung ohne Beschädigungen

Die SMT-II von Teknek setzt neue Maßstäbe für die Reinigung von SMT Leiterplatten.

Mit einer Reinigung unter extrem niedriger statischer Aufladung und geringer Druckausübung bietet die SMT-II die perfekte Methode für die Beseitigung von Verunreinigungen vor dem Pastendruck.

Um den industriellen Anforderungen an eine erweiterte Traceability und Integration gerecht zu werden, wird die SMT-II standardmäßig mit einer IPC Hermes Schnittstelle geliefert.

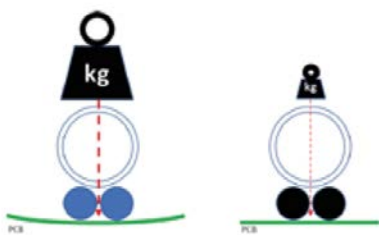
Eigenschaften



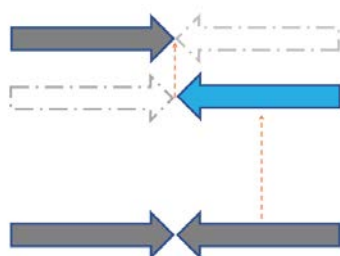
Network



Interface



Low Applied Pressure



Follow-Me

Vorteile

Jedes Bestandteil der SMT-II ist speziell für eine Reinigung von Boards in einer Umgebung mit geringer statischer Aufladung konzipiert. Dies wird durch ein durchdachtes Design sowie mit Hilfe der patentierten Elastomer- und Adhäsivtechnologie erreicht.

Die Kommunikation zwischen den einzelnen Systemen innerhalb des SMT Prozesses war niemals wichtiger. Die SMT-II wird deshalb nicht nur voll integriert sein, sondern auch standardmäßig mit einer IPC-Hermes- oder SMEMA-Schnittstelle geliefert.

Mit der neuen Benutzeroberfläche, die extrem einfach zu bedienen ist, werden die Inbetriebnahme und Nutzung der SMT-II zu einem Kinderspiel.

Unserer Technologie erfordert immer dünnere und komplexere Boards, die häufig auch besonders empfindlich sind. Jegliche Druckausübung an irgendeinem Punkt innerhalb des Bestückprozesses kann zu Beschädigungen führen.

Die SMT-II hebt sich gegenüber anderen Reinigungssystemen dadurch besonders ab, dass sie den geringsten Druck ausübt und dennoch eine hohe Reinigungseffizienz erreicht – ohne das Risiko von Beschädigungen.

Eine Option der neuen SMT-II ist „Follow Me“. Falls der SMT Prozess nicht von Hermes kontrolliert wird, überwacht dieses unabhängige System zur automatischen Breitenverstellung kontinuierlich die bewegliche Spur vor oder nach der SMT-II.

Der Bediener muss beim Boardwechsel nicht eingreifen, was wiederum Zeit und Kosten spart.

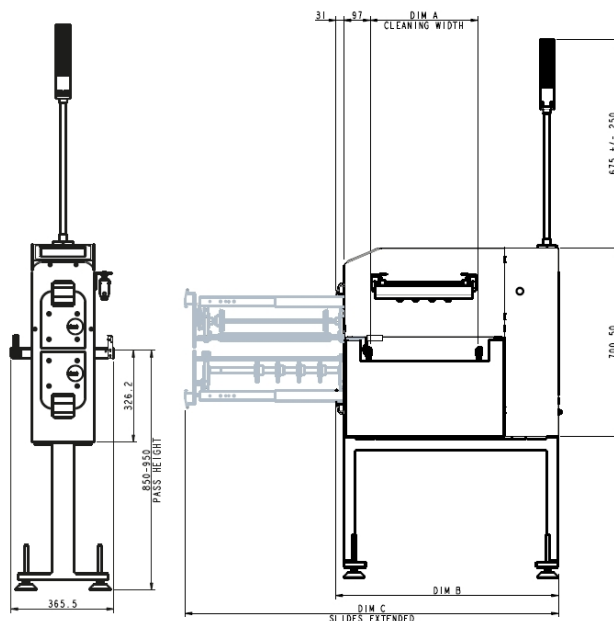
SMT-II Low Static Reinigungssystem – Technische Spezifikationen

Beschreibung	
Zwei Reinigungsbreiten	40 – 400 mm 40 – 600 mm
Betriebsmodus	Doppelseitige Reinigung und Durchlauf oder einseitige Reinigung und Durchlauf
Elastomer Rollen	NT™ oder UTF-Nanoclean™
Adhäsivrollen	AREP oder AREF
Prozessgeschwindigkeit	1-40 m/min.
Durchlaufhöhe	900 +/-50 mm
Spannungsversorgung	85-265Vac
Druckluftversorgung	5-7 bar ölfreie Druckluft
ESD Kompatibilität	
Maschine	ANSI / ESDs 6.1-2014 & IEC 61340-5-1 2016
Alle Rollen	ISO 6123 Klasse A
NT™/Nanoclean™ 20.20	ANSI / ESDs 20.20-2014
Adhäsive	FINAT

Verwendbare Leiterplattengrößen und -dicken

		SMT-II/400	SMT-II/600
Einseitige Reinigung	Min - Max Länge	50mm - N/A	50mm - N/A
	Min - Max Breite	40mm - 400mm	40mm - 600mm
	Min - Max Dicke	0.6mm - 3.2mm	0.6mm - 3.2mm
Durchlauf ohne Reinigung	Min - Max Länge	50mm - N/A	50mm - N/A
	Min - Max Breite	40mm - 400mm	40mm - 600mm
	Min - Max Dicke	0.6mm - 3.2mm	0.6mm - 3.2mm
Doppelseitige Reinigung	Min - Max Länge	98mm - N/A	98mm - N/A
	Min - Max Breite	40mm - 400mm	40mm - 600mm
	Min - Max Dicke	0.6mm - 3.2mm	0.6mm - 3.2mm
Durchlauf ohne Reinigung	Min - Max Länge	120mm - N/A	120mm - N/A
	Min - Max Breite	40mm - 400mm	40mm - 600mm
	Min - Max Dicke	0.6mm - 3.2mm	0.6mm - 3.2mm

Abmessungen der SMT-II



Maschinen Breite	Reinigungs- breite	Komplette Breite	Ein- und Auslauf ausgefahren
	DIM A	DIM B	DIM C
SMT-II/400	400	828	1388
SMT-II/600	622	1078	1878

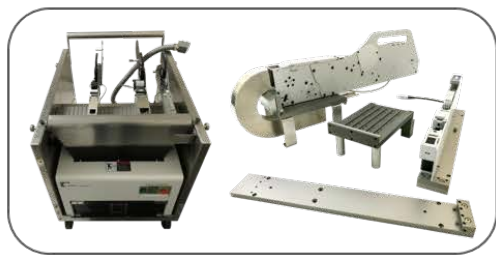
Unser Produktportfolio



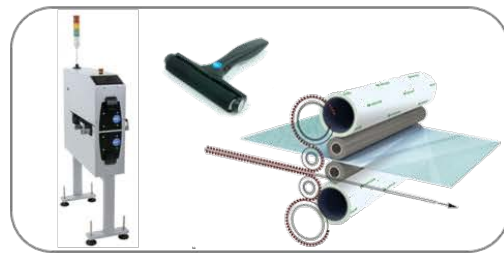
Zuführtechnologie



Label Feeder, Labels und Kennzeichnungslösungen



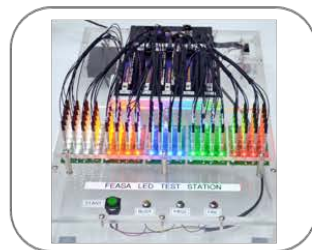
Sonderapplikationen



Bare Board Reinigung



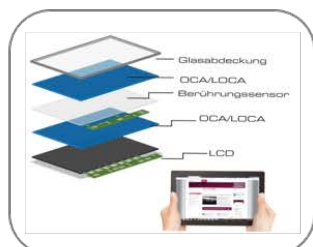
In-System Programmierung



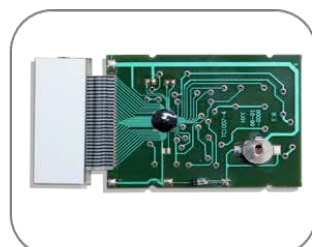
LED Analyse



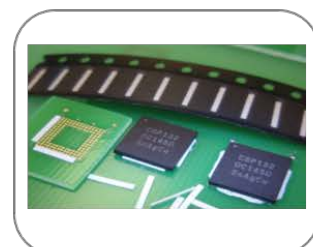
Reflow Inline Kamera



Optical Bonding



Thermal Bonding



Place-N-Bond